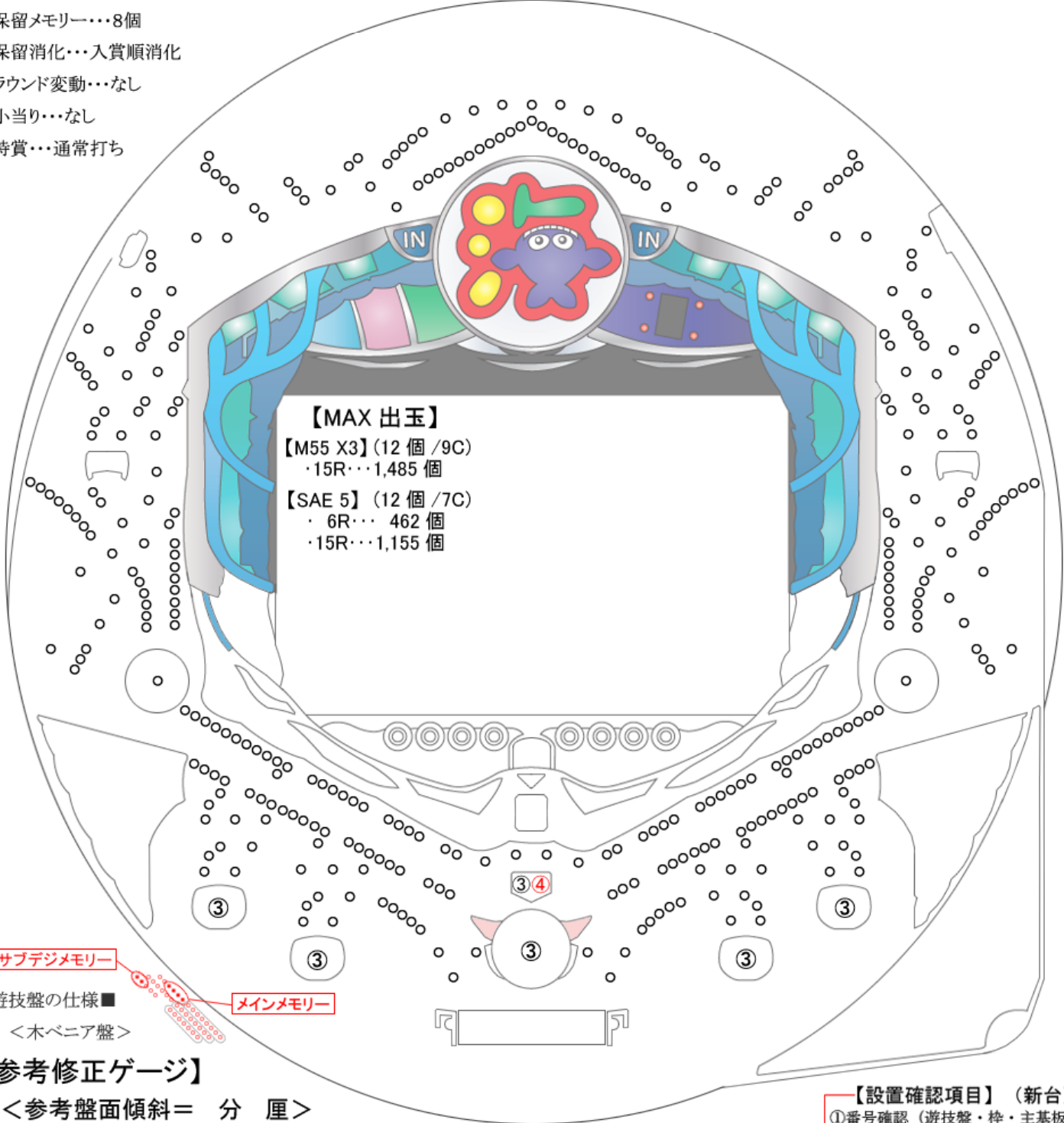


【M55 X3】 確率 = 1/319.6 確変 = 54.0% 電サボ = フル / 100 回 賞球 = 3&3&3&12

【SAE5】 確率 = 1/89.8 確変 = 100%(ST=5) 電サボ = フル ST 含 / 25/50/100 回 賞球 = 4&3&3&12

- 潜伏確変仕様…なし
- 保留メモリー…8個
- 保留消化…入賞順消化
- ラウンド変動…なし
- 小当り…なし
- 特賞…通常打ち



【MAX 出玉】

【M55 X3】 (12 個 / 9C)
・15R…1,485 個

【SAE 5】 (12 個 / 7C)
・6R…462 個
・15R…1,155 個

サブデジメモリー

メインメモリー

■遊技盤の仕様■

< 木ベニア盤 >

【参考修正ゲージ】

< 参考盤面傾斜 = 分 厘 >

【設置確認項目】 (新台)

- ①番号確認 (遊技盤・枠・主基板)
- ②主基板 (かしめ・封印シール)
- ③払出基板 (ケース破損・開封)
- ④その他基板 (破損・開封・コネクタ)
- ⑤遊技釘・風車 (本数・形状・材質)
- ⑥発射装置 (実発射にて確認)
- ⑦払出装置 (実入賞の払出にて確認)
- ⑧図柄作動確認 (液晶・メイン・サブ)

【点検確認】 (部品)

- | | |
|---|---|
| <p>A : 製造番号・番号票の点検 1:遊技盤番・2:枠・3:主基板</p> <p>B : 主基板等の点検 4:主基板のケース異常・開封 5:主基板の形状異常・異物 6:払出基板のケース異常・開封 7:払出基板の形状異常・異物 8:ロムの形状・装着異常</p> <p>C : 形状異常・異物の点検 9:周辺基板・10:中継端子板 11:外部端子板・13:コネクタ 12:ユニット接続端子板・14:配線 15:裏バック・16:遊技くぎ及び風車 17:上下皿</p> | <p>D : 発射装置の点検 (確認) 18:タッチセンサー作動確認 19:発射個数・20:球飛び位置</p> <p>E : 遊技基本動作の点検 (確認) 21:入賞賞球数・22:最大入賞数 23:役物作動・24:図柄表示作動</p> <p>F : その他の点検 25:全ての接続箇所点検 26:スピーカーの作動確認 27:各種ランプの点灯確認</p> |
|---|---|